信达证券 CINDA SECURITIES

Research and Development Center

产能为王，再谈 IDM 及设备投资机遇

电子行业周报

2021 年 01 月 18 日

证券研究报告

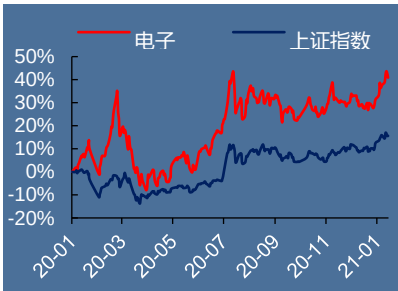
行业研究

行业周报

电子

投资评级 看好

上次评级 看好



数据来源：万得，信达证券研发中心

方 竞 电子行业首席分析师
执业编号：S1500520030001
邮 箱：fangjing@cindasc.com

李 少 青 电子行业分析师
执业编号：S1500520080004
邮 箱：lishaoqing@cindasc.com

刘 志 来 研究助理
邮 箱：liuzhilai@cindasc.com

童 秋 涛 研究助理
邮 箱：tongqiutao@cindasc.com

信达证券股份有限公司
CINDA SECURITIES CO.,LTD
北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
邮编：100031

产能为王，再谈 IDM 及设备投资机遇

2021 年 01 月 18 日

本期内容提要：

➢ **每周专题：产能为王，再谈 IDM 及设备投资机遇。**

1、供给收缩、需求放量，供不应求或成长期态势。

近期半导体板块最热门的话题莫过于涨价潮。据集微网统计，20 年 11 月份以来国内共有超过 21 家芯片企业发布涨价通知，幅度平均在 10%-20%之间。除涨价外，产能紧缺已导致部分行业面临减产，如近期盖世汽车报道，福特、丰田、日产、大众和戴姆勒等均因芯片短缺或将减产。**究其原因，我们认为缺货涨价的背后是供需失衡。**

供给端收缩：由于全球疫情影响，外加美光、海力士、东芝等存储厂商频繁的停电失火等工厂事故，海外晶圆厂稼动率普遍不高。此外，近期的中芯事件，加剧了下游厂商对供应链安全的担忧，重复下单亦有一定影响。

需求端放量：手机方面，伴随疫情消散，手机市场有所回暖，台积电指引 2021 年全球手机市场增速达 10%。服务器方面，信骅科技连续两月营收同比环比均录得增长，预示 1H 服务器市场需求强劲。PC 方面，2020 年 Q4 全球出货量同比增长达 26.1%，接近历史最高增速。汽车电子方面，特斯拉上海厂持续扩产，周产量达 8000 辆。

我们认为，供给端收缩更多是疫情及外围因素带来的短期扰动，而需求端放量才是驱动半导体景气度长期向上的核心逻辑。参考 WSTS 的数据统计，6 月份 WSTS 预计 20/21 年全球半导体增速分别为 3.3%/6.2%。而 11 月便已上修至 5.1%/8.4%。而当下台积电更是上修 2021 年全球半导体增速至 10%。充分体现了**下游市场需求正不断超产业界预期。缺货涨价或成长期态势。**

2、产能为王，IDM 及设备厂商将充分受益。

我们认为缺货涨价态势下，**Fabless 厂商和 Fab/IDM 之间的话语权会重置。**Fab 可通过涨价，获取更多的业绩弹性；IDM 可凭借自有产能优势，保证下游客户供给，从而抢占市场。此外，相较数字及模拟 IC，功率半导体更偏标准品，可替代性更强。如海外厂商缺货，可快速形成国产替代。**建议关注功率 IDM（中车时代电气、士兰微、闻泰科技、华润微等）。**

为缓解产能不足的难题。各大晶圆厂及 IDM 亦将大举扩产，台积电 2021 年 CAPEX 超预期，同比增长 45%-63%便为典例。我们有理由认为**承接涨价周期的，必然是资本开支增长周期。**Bloomberg 数据显示，海外主要存储器厂商美光、海力士自 2020 年以来资本开支均呈逐季增加趋势；国内长江存储，合肥长鑫等亦开启新产能建设招标。

全球晶圆厂产能建设加码，叠加半导体设备国产替代的刚需，我们看好本轮扩产周期中本土半导体设备厂商的投资机会。**建议关注北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微。**

3、封测行业同样供不应求，涨价驱动业绩弹性

我们还观测到，目前封测行业的产能短缺也是极为严重，除下游需求推动外，还有更多因素影响了封测业的供需结构。**1）东南亚转单：**东南亚是全球 IDM 厂商封测的大本营，无论是英特尔、TI、安森美、Infineon 均在马来、菲律宾等国有封测产能。而**东南亚诸国近期受疫情影响再度开启行动管制，使得不少 IDM 厂商转单大陆。2）设备交付延后：**由于国际主流

封测设备商的生产基地主要在欧美地区，稼动率不高影响设备交付，Leadtime 目前已延长至 7 个月左右，使得产能短期内无法快速扩张。

据产业链调研，目前主流封测厂商涨价有 20%左右。可以显著推动公司业绩表现。此外，国产设备厂商亦会在此过程受益，通过产能扩建提升交付能力，获取更多订单。**建议关注：封测龙头（长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技）以及封测设备厂商（华峰测控、ASMP）。**

- **半导体：台积电上修业绩展望，长线看多半导体板块。**

台积电作为全球晶圆厂龙头，其业绩指引是整个半导体产业链景气度的风向标。本周 1 月 14 日，台积电召开业绩说明会，公司除了给出超预期的业绩表现之外，还对 21 年的半导体行业及自身 CAPEX 给出了指引。

（1）业绩表现略超指引，5nm 工艺迎来爆发：台积电 Q4 营收 126.8 亿美元，环比增长 4.45%，同比增长 22.04%，略超前期指引。展望 21 年 Q1，公司预计 HPC、汽车、AIOT 等持续增长，不过智能手机将环比下滑，因此 Q1 营收 127 亿美元-130 亿美元，同比 23%-26%。

（2）终端需求强势，公司上修长期指引：公司预计 21 年全球智能手机出货量同比增长 10%，5G 手机渗透率将从 20 年的 18％增长到 2021 年的 35％以上。整个半导体市场（不含存储）增速为 8%左右，21 年全球晶圆代工产业增速预计将达 10%。同时，公司长期看好智能手机、HPC、汽车、AIOT 景气度上行，预计 21 年公司营收将同比增长 14-16%，2020 年-2025 年 CAGR 从原来的 5%-10%提高到 10%-15%。

（3）21 年资本开支规划大超预期，持续加大先进制程投入：台积电去年资本支出为 172 亿美元，2021 年的资本支出将介于 250 亿-280 亿美元，同比增长 45%-63%。其中 80％将用于 3nm、5nm、7nm 等先进制程，大约 10％会用于先进封装及光罩制作，另外约 10％会用于特殊制程。台积电目前正与客户合作开发先进的 3D 封装技术，SoIC 预计将于 2022 年量产，并将首先应用于 HPC 领域。整体来看，公司预计包括 InFo 在内的先进封装等未来几年内将高于公司平均增速（10%-15%）增长。

- **面板：TCL 科技业绩超预期强化市场信心，京东方定增回收新线股权充分享受业绩释放。**

本周面板双子星均有较为重磅的公告出炉：

1）TCL 科技业绩预告：1 月 11 日，TCL 科技发布 2020 年年度业绩预告，预计 2020 年全年实现归母净利 42-44.6 亿元，同比增长 60%-70%；对应单四季度归母净利润 21.75-24.35 亿元，环比增长 13.58-16.18 亿元。

TCL 业绩超市场预期，我们认为主要系面板价格上涨和公司内生产能释放及外延资产并购的共同作用。价格方面，根据 Witsview 数据显示，四季度各主流尺寸 TV 面板价格大幅上涨 18%-20%。且预计 1 月份面板价格将维持涨势，Witsview 一月上旬报价仍上涨 2%-3%。**内生新建和外延并购方面，**公司 11 代线 T6 于 2019 年年底满产，伴随着疫情消散，于 2H20 充分释放产能，T4 AMOLED 产线一期也于 19 年四季度开始量产，产能释放持续整个 20 年。而中环也于 20 年 10 月份并表，四季度贡献业绩近亿元。

2）京东方定增：1 月 15 日，京东方发布公告，拟非公开发行不超过公司总股本 20%的 A 股股票；拟募资不超过 200 亿元。募集资金主要用于：1）收购武汉京东方光电 24.06%的股权（约 65 亿元）；2）对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目（约 60

亿元）。此外，募集资金还用于：对云南创视界光电增资、对成都京东方医院增资、偿还福州城投集团贷款和补充流动资金。

公司本次募集资金主要用于收购武汉京东方股权和增资重庆京东方。其中武汉京东方光电是 10.5 代线（B17）的归属企业。本次收购 **24.06%股权作价 65 亿元，相对于注册资本溢价 3.9%。通过完成收购，京东方持有武汉京东方的股权将由 23.08%增至 47.14%。**在行业景气度提升的大背景下，公司通过收购大幅提升 B17 产线的股权比例，有助于充分享受面板价格上行的红利，增厚公司业绩。

而重庆京东方是 6 代柔性 OLED（B12）的归属企业。该条产线预计总投资额 460 亿元，京东方持股比例为 38.46%。通过向重庆 AMOLED 线增资，公司将加快完成新产线建设，并进一步扩大在柔性 OLED 显示领域的领先优势。

3）估值方面，目前龙头公司已开始开始反应 21 年业绩预期，但当前估值仍极具吸引力。TCL 科技、京东方 A 股价对应 21 年 PE 仅 14、18 倍，22 年仅 12、14 倍，该板块仍属于价值洼地，继续强烈推荐。

- **投资评级：**

本周电子板块行情主要围绕面板及半导体设备展开，其中 TCL 科技发布业绩预告，带动面板板块持续上行，而半导体设备公司的华峰测控、北方华创及中微公司亦均有优异表现。我们看好电子板块的长线发展，无论是消费电子的产业链转移及新品类创新，还是半导体板块的涨价潮叠加国产替代，亦或是面板龙头的业绩释放。都是今年确定性极高的投资机遇。建议关注以下优质标的，**功率半导体：**中车时代电气、士兰微、斯达半导、华润微、新洁能。**半导体设备：**北方华创、中微公司、至纯科技、芯源微、华峰测控、ASMP。**封测龙头：**长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技；**半导体设计：**韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦、晶丰明源、富瀚微；**面板龙头：**TCL 科技，京东方 A；**消费电子：**立讯精密、歌尔股份、长盈精密、舜宇光学；**电子品牌：**小米集团、传音控股、安克创新。

- **风险因素：**疫情影响反复；市场需求不及预期。

目 录

附录一：上周市场回顾 6
附录二：上周科技新闻回顾 9
附录三：近期重要行业数据整理更新 14
附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒 15

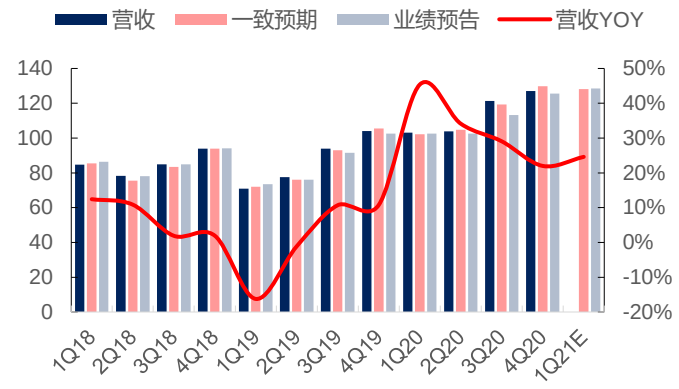
表 目 录

表 1：2019-2020 全球存储器晶圆厂事故及停产情况整理 7
表 2：重要指数和价格变化 8

图 目 录

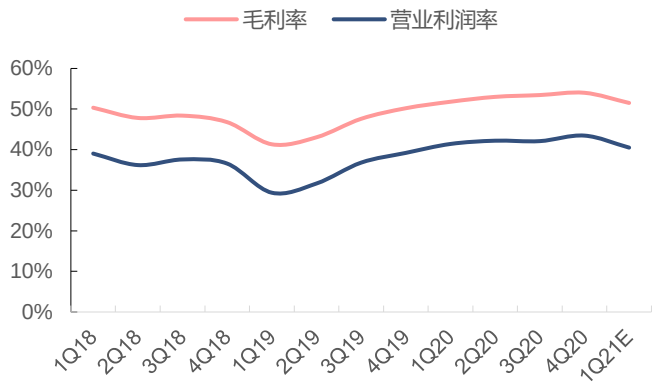
图 1：台积电季度营收及同比（亿美元） 6
图 2：台积电季度毛利率及营业利润率 6
图 3：台积电历年来资本支出（亿美元） 6
图 4：台积电晶圆出货量（千片） 6
图 5：台积电各制程营收结构 6
图 6：台积电各下游市场营收结构 6
图 7：2019-2021DRAM 价格（美元）(DDR3 4Gb 1600MHz） 7
图 8：2013-2020 年主要存储厂商 capex（百万美元） 7
图 9：电子行业子板块周涨跌幅（%） 8
图 10：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%） 8
图 11：近五年 NB 出货量（百万台） 14
图 12：近五年全球伺服器出货量（百万台） 14
图 13：台企伺服器代工出货量（万台） 14
图 14：各价位段智能手机全球出货占比（以美元计） 14
图 15：特斯拉全球电动车季度交车量情况（万辆） 14
图 16：蔚来 2020 年 1-12 月电动车交车量变化（辆） 14

图 1：台积电季度营收及同比（亿美元）



资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

图 2：台积电季度毛利率及营业利润率



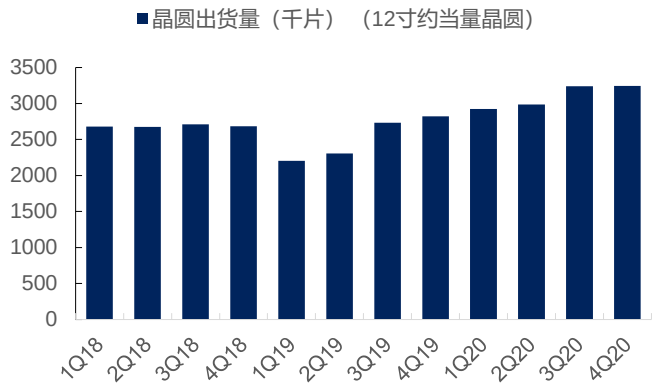
资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

图 3：台积电历年来资本支出（亿美元）



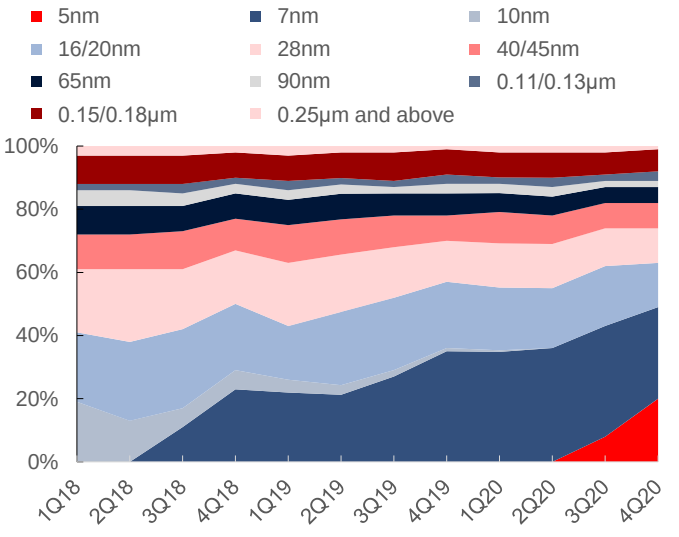
资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

图 4：台积电晶圆出货量（千片）



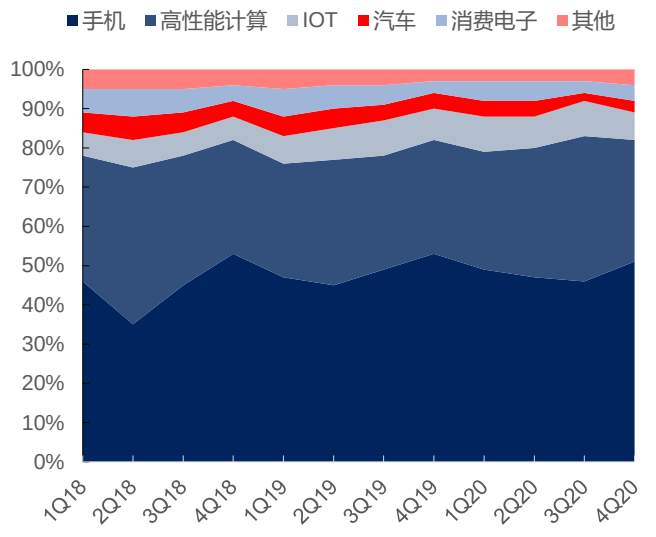
资料来源：台积电，信达证券研发中心

图 5：台积电各制程营收结构



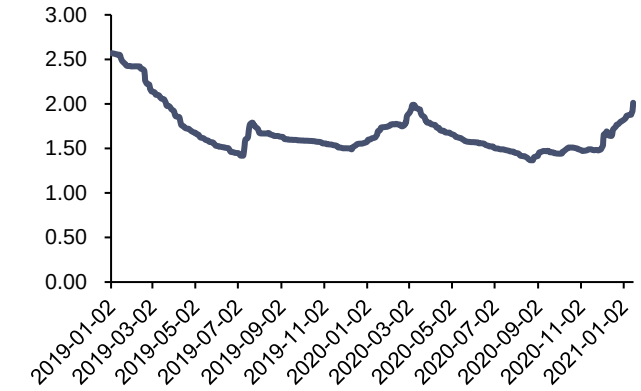
资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

图 6：台积电各下游市场营收结构



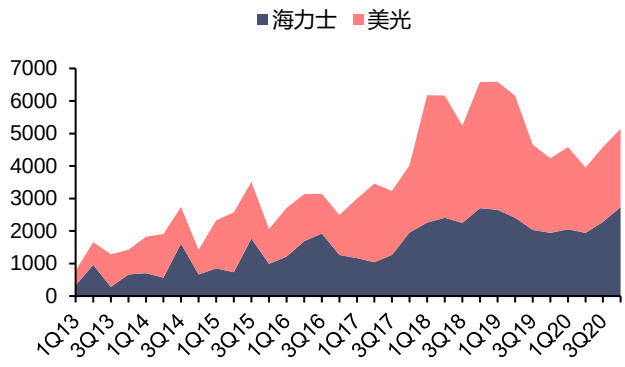
资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

图 7：2019-2021DRAM 价格（美元）（DDR3 4Gb 1600MHz）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 8：2013-2020 年主要存储厂商 capex（百万美元）



资料来源：Bloomberg，信达证券研发中心

表 1：2019-2020 全球存储器晶圆厂事故及停产情况整理

时间	厂商	事件
2020-12	美光	美光台湾桃园内存晶圆厂停电
2020-11	海力士	海力士重庆封测厂因员工确诊新冠停产
2019-12	三星	三星首尔内存、闪存厂停电
2019-06	西数	日本地区 5 座闪存晶圆厂停电

资料来源：公开资料整理，信达证券研发中心

附录一：上周市场回顾

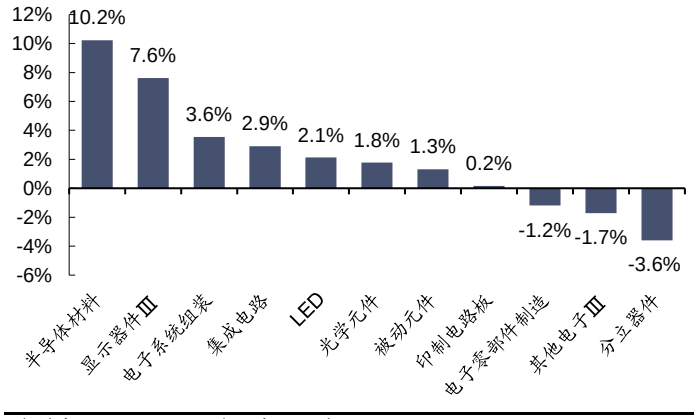
电子板块上周上涨 2.3%，跑赢沪深 300 指数 3.0 个百分点。年初至今电子板块上涨 7.2%，跑赢沪深 300 指数 2.5 个百分点。上周电子行业子版块涨幅分别为半导体材料 10.22%，显示器件Ⅲ 7.61%，电子系统组装 3.55%，集成电路 2.91%，LED 2.12%，光学元件 1.78%，被动元件 1.32%，印制电路板 0.16%，电子零部件制造 -1.19%，其他电子Ⅲ -1.71%，分立器件 -3.60%。就个股而言，上周彩虹股份、华峰测控、TCL 科技、至纯科技、精测电子涨幅居前，分别上涨 32.2%、25.9%、24.8%、24.0%、22.2%。

表 2：重要指数和价格变化

全球股指	指数	周度涨跌幅	年初至今涨跌幅	原材料	价格	涨跌幅
沪深 300	5458.1	-0.7%	4.7%	LME 铝	1982.0	-2.0%
上证综指	3566.4	-0.1%	0.7%	LME 铜	7934.0	-2.4%
中小板指	10109.7	-2.0%	7.1%	DCE 塑料	7605.0	0.8%
创业板指	3089.9	-1.9%	0.9%	LME 镍	18050.0	2.2%
道琼斯	30814.3	-0.9%	4.3%	LME 锡	21125.0	0.6%
SOX	2992.8	1.9%	0.5%	LME 锌	2686.0	-4.5%
纳斯达克	12998.5	-1.5%	1.1%	人民币汇率		
A 股电子	5073.5	2.3%	7.2%	美元	6.525	-0.24%
恒生科技	22430.1	4.7%	6.8%	欧元	8.025	0.19%
台湾加权	15616.4	1.0%	6.0%	100 日元	6.324	-0.19%
台湾 IT	23168.8	3.3%	11.9%	新台币对美元	28.090	-0.02%

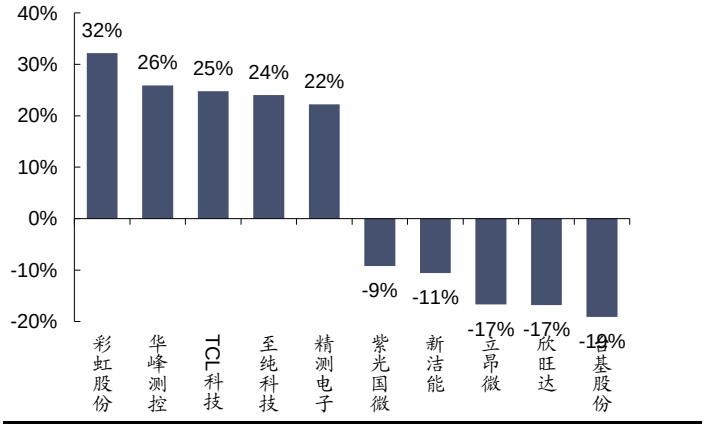
资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 9：电子行业子板块周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

图 10：电子行业个股周涨跌幅前五后五（%）



资料来源：Wind，信达证券研发中心

附录二：上周科技新闻回顾

1、消费电子

iPhone12 Pro 中美大缺货，苹果上调供货量鸿海提前抢人

iPhone 12 系列去年 10 月起上市，迄今已约三个多月，部分机种持续处于缺货状态，苹果大陆、美国官网显示高端机型仍缺货。iPhone 12 Pro 机型大部份到货时间仍长达二至三周。因应庞大需求，主力代工厂鸿海集团旗下富士康郑州厂 iDPBG 事业群提前展开抢人大作战，继针对派遣工祭出高额奖金留人后，近期再对寒假工、正式工启动新一轮征才活动，主要针对河南郑州厂内部推荐寒假工，介绍人奖金人民币 1500 元，求职者春节出勤激励人民币 2000 元。同时，针对正式工部分，郑州厂也祭出推荐人奖励人民币 600 元，被推荐人奖励人民币 3600 元，若加上春节出勤激励人民币 3600 元，总奖金高达人民币 7800 元。（集微网）

消息称华为 4G 相关元器件、设备和技术供应均已获许可证 5G 仍未松动

集微网消息，据科创板日报，记者从供应链多位人士处独家获悉，华为 4G 接近全部电子元器件、设备和技术供应商已获美国商务部许可证。消息人士称：“获得许可证的品类非常多，几乎是有关 4G 的全部，但是 5G 相关还没松动。”（集微网）

三星跟进不附插头

三星最新旗舰手机 S21 将于 2021 年 1 月底在全球开卖，本次三星确认不随盒装附赠充电插头及有线耳机。（中时电子报）

高通发布了第二代超声波屏下指纹

高通发布了第二代超声波屏下指纹识别器 3D Sonic Sensor Gen 2。高通承诺，通过将更大的传感器与更快的处理速度相结合，扫描指纹来解锁手机的速度将比初代快 50%。新的 3D Sonic Sensor Gen 2 的尺寸为 8×8 毫米，而第一代型号的面积为 4×9 毫米，这意味着面积增加了 77%。（闪信息）

或由京东方供屏！LG 确认今年发布首款量产卷轴屏手机

随着 OPPO 在未来科技大会上正式公布 OPPO X 2021 卷轴屏概念机，自折叠屏后又一次革命性的带来了全新的手机形态，引发了行业内的热议。据外媒报道，近日，LG 在 CES2021 新品发布会的宣传片中，展示了其旗下新款卷轴屏手机 LG Rollable，而这款手机有望成为今年首款量产的卷轴屏手机。据行业内知情人士透露，目前 LG 正在与京东方进行合作来生产卷轴屏手机，该屏幕将基于柔性有机发光二极管技术。（群智咨询）

OPPO、vivo、小米大举追加订单，联发科挤下高通成为台积电第三大客户

据台湾《工商时报》报道，由于 OPPO、vivo、小米等大陆手机厂大举追单，IC 设计龙头联发科 5G 手机芯片接单大幅增长，预期 2021 年上半年出货量将达 8,000～9,000 万套规模，约达 2020 年全年出货量的 1.6～1.8 倍。联发科第一季扩大对台积电 7nm 的投片，6nm 旗舰级 5G 芯片天玑 1200 也开始量产，第一季在台积电 7、6nm 投片量达 11 万片，挤下高通成为台积电第三大客户。（集微网）

联想集团计划在科创板上市

1 月 12 日晚间，联想集团在港交所发布公告称，公司今日向香港联合交易所有限公司提交公告，宣布董事会已

批准可能发行中国存托凭证（CDR）、并向上海证券交易所科创板申请 CDR 上市及买卖的初步建议。（集微网）

2、半导体

Counterpoint：预测 2021 年晶圆行业总收入 920 亿美元

2020 年，晶圆行业收入达到约 820 亿美元，同比增长 23%。尽管 2020 年的基数很高，但两位数增长将在 2021 年持续，Counterpoint 预测总收入为 920 亿美元，同比增长 12%。台积电从 1Q20 开始开始其 5 纳米批量生产，三星则在 6-9 个月后紧随其后。5 纳米被认为是两家代工厂都完全采用的 EUV 节点，因为英特尔等效的 7 纳米宣布在 2020 年再次推迟生产。根据 Counterpoint 的估计，5 纳米的晶圆总出货量将在 2021 年占全球晶圆代工行业 12 英寸晶圆的 5%(2020 年的不到 1%)。苹果是 2021 年 5 纳米制程的最大客户(所有订单都向台积电提供)。（闪信息）

Gartner 预计 2020 年全球半导体收入反弹

Gartner 发布了他们对 2020 年半导体的营收预测。按照他们的说法，继 2019 年下降 12％之后，2020 年全球半导体收入反弹至总计 4,498 亿美元，较 2019 年增长 7.3％。（半导体行业观察）

IC insights：2020 年半导体行业并购协议价值创新高

IC insights 指出，2020 年半导体行业并购协议总值达到 1,180 亿美元，创历史新高，超过 2015 年的 1,077 亿美元。其中最大的五笔并购协议总价值为 940 亿美元，约占全年总额的 80%。（IC insights）

台积电第四季度净利润 1428 亿新台币 同比增长 23%

1 月 14 日，台积电发布了截至 12 月 31 日的 2020 年第四季度财报，总营收为 3615.3 亿元新台币，同比增长 14.0%。净利润为 1427.7 亿元新台币，同比增长 23.0%。（SEMI）

联电 28nm 供不应求，客户欲投资换产能

半导体供应链传出，三星为了追赶日商索尼（Sony）在 5G 智能手机 CMOS 图像传感器的龙头厂市占率，大举对联电追加 28 纳米 5G 智能手机 ISP 产能，并有意投资机台设备以保障产能。（半导体行业观察）

2021 年台积电将投入逾 150 亿美元用于 3nm 工艺

据 digitimes 报道，业内人士透露，台积电计划在 2021 年投入超 150 亿美元推进公司的 3nm 工艺技术。（集微网）

超 21 家芯片企业发布涨价通知，最高涨幅 50%

不完全统计发现，截至目前，共有超过 21 家芯片企业发布涨价通知，从披露来看，涨价幅度平均在 10%-20%之间，个别企业如得一微电子，其嵌入式存储控制芯片上调 50%，成为了涨价幅度较大产品之一。从每家的通知来看，涨价原因大同小异，主要原因是：由于上游原材料以及封装成本持续上涨，且产能紧张、采购周期延长，产品成本大幅增加，故提升产品价格来分摊成本压力。（集微网）

Omdia：三星 CMOS 图像传感器涨价 40%

据 Omdia 报告，应用在中低端手机的 500 万和 800 万像素的 CIS 正面临严重的短缺现象。三星从 2020 年 12 月开始将其 CIS 的价格提升 40%，而其他 CIS 供应商价格也提升了 20%左右。（半导体行业观察）

封测产能遭疯抢，客户不问价格，只要产能

据台媒工商时报报道，封测产能严重吃紧，半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满，订单超出产能逾 40％，涨价 30％还是有客户接受涨价只要产能，以避免缺芯片、出不了货情况再度发生。（半导体行业观察）

两家芯片公司开启辅导备案，半导体 A 股队伍再壮大

浙江监管局披露了国芯科技辅导备案公示文件，国芯科技成立于 2001 年，专注于物联网应用领域芯片设计与系统方案开发；广东监管局披露希荻微电子辅导备案文件，专注于各类移动通信设备、汽车电子等应用的模拟芯片产品（全球半导体观察）

3、汽车电子

芯片短缺致福特、丰田、日产和 FCA 减产

1 月 8 日，福特、丰田、日产和 FCA 表示，因芯片短缺本月将减少汽车产量。随着需求从疫情危机中反弹，上述车企成为最近一批受到芯片危机打击的汽车制造商。此外，本田表示，其在日本的汽车产量也可能受到影响。（盖世汽车）

大众因半导体短缺再次减产

1 月 13 日，大众表示，因半导体短缺对全球汽车业造成冲击，该公司将进一步削减其德国北部主要工厂的汽车产量。此外，在沃尔夫堡工厂生产途观、途安和西雅特 Tarraco 车型的员工将减少工作时间，且高尔夫车型的生产工作已经受到影响。（盖世汽车）

戴姆勒因芯片短缺将减产

据德国商报 1 月 14 日报道，戴姆勒将削减德国不来梅工厂的产量，并可能在 2 月初关停一段时间。（盖世汽车）

汽车厂商押注 SiC

近日据韩媒报道，LG 集团旗下子公司 Silicon Works 日前宣布扩大其半导体业务，重点押注碳化硅 PMIC 以及 MCU。（半导体行业观察）

英特尔自动驾驶汽车部门 2025 年前加快应用其雷达技术

1 月 12 日，英特尔旗下自动驾驶汽车子公司 Mobileye 负责人表示，该公司希望到 2025 年前能转而使用自己的雷达技术，每辆汽车配备一个激光雷达传感器，旨在降低自动驾驶的成本。（盖世汽车）

韩国将向自动驾驶项目注资 1.1 万亿韩元

1 月 14 日，韩国政府官员表示，到 2027 年，韩国将向研发自动驾驶技术和建设相关基础设施的项目投资 1.1 万亿韩元（约 9.99 亿美元）。韩国贸易、工业和能源部、科学和信息通信技术部、土地、基础设施和运输部和韩国

国家警察厅将共同资助这些项目，以推动自动驾驶汽车的商业化。（盖世汽车）

苹果现代或 3 月签合作协议

据韩国媒体 Korea IT News 在 1 月 10 日报道，现代汽车和苹果公司计划在今年 3 月前就自动驾驶电动车签署合作协议，并将在 2024 年左右开始投产。1 月 11 日上午交易中，现代汽车股价上涨 14.6%，现代摩比斯和起亚汽车分别上涨 12.7%和 9.1%。（盖世汽车）

外媒：苹果去年上半年曾欲收购电动汽车初创公司 Canoo

据外媒 The Verge 报道，苹果 2020 年上半年与专注于电动汽车及相关技术的初创公司 Canoo 进行了会谈，讨论了从投资到收购的几种选择，这是苹果进一步推动电动汽车项目的一部分。（集微网）

百度造车

1 月 11 日，百度宣布，联合吉利组建一家合资公司百度汽车，以整车制造商的身份进军汽车行业，面向乘用车市场，让用户购买到更极致的智能电动汽车。外媒此前报道，合资公司中，百度拥有控股权和多数投票权，吉利只是少量出资。（盖世汽车）

官宣牵手富士康之后，拜腾近期拟组建合资公司“富腾”

1 月 4 日，拜腾汽车与富士康科技集团、南京经济技术开发区签署战略合作框架协议，拜腾联席 CEO 丁清芬等人出席了本次签约仪式。丁清芬向全体员工表示，计划近期将与富士康组建合资公司“富腾”。会议提到，公司计划在 12-15 个月内实现 M-Byte 的 SOP。（盖世汽车）

4、面板/LED/PCB 等

TCL 发布两款柔性 OLED

TCL 发布了两款全球首款柔性屏，一个是 6.7 英寸 AMOLED 云卷屏，通过滑动机壳可使卷藏于内部的柔性屏被“拉出”，让 6.7 英寸的屏幕快速延展成 7.8 英寸。TCL 华星通过柔性屏的强化设计使柔性屏的卷曲滑动半径可小至 R3mm，搭载滑动机构的卷曲滑动寿命 10 万次。（闪信息）

TCL 发布 MiniLED 背光技术与电视

TCL 推出了升级版的 OD Zero MiniLED 技术，将背光层和 LCD 层之间的距离缩小到 0mm，从而让背光更加均匀。此外，TCL 还宣布了全新的智能电视阵容，其中，4K MiniLED C825 电视采用多分区背光控制技术，与量子点显示技术，同时还内置电竞神装功能。（LEDinside）

新突破！京东方合作伙伴 Rohinni 宣布 MiniLED 转移速度翻倍

1 月 11 日,美国 Rohinni 宣布，MiniLED 转移技术获突破。MiniLED 转移速度达每秒 100 次,新技术有效将转移速度翻倍,成本减半。Rohinni 称,消费者、汽车和户外标识牌等市场的 OEM 厂商均可以采用其转移技术,生产出比现有产品更优的产品,实现更高亮度、更轻薄、更低功耗等特点。Rohinni 表示,新技术有助于 MiniLED 的快速应用，MiniLED 有望在 2021 年广泛应用于电视、视频墙、消费电子产品等方面。（群智咨询）

群创推出多款 MiniLED 背光产品

群创展出采用 MiniLED 背光显示技术的 120 寸 8K/4K 高阶电视和 11.6 寸 MiniLED 车用显示器等产品。其中，11.6 寸 MiniLED 车用显示器具高对比、高色饱、高解析度、低功耗等特点。（LEDinside）

三星显示展示首款屏摄像头的三星 OLED 笔记本电脑

三星显示展示了其首款屏摄像头的三星 OLED 笔记本电脑。三星展出了 Samsung BLADE BEZEL 技术商标。而电脑采用时尚的外形设计，得益于屏下摄像头技术(UPC)，拥有透明摄像头孔。而超薄的屏幕边框还给三星 OLED 笔记本电脑带来了高达 93%的屏幕占比。（闪信息）

订单排超 4 个月，芯片电阻大厂传暂停接单

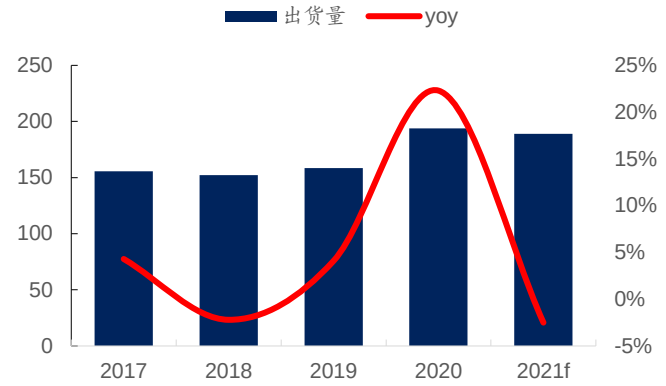
在华新科大朗厂火灾后，由于客户担忧芯片电阻后续供应受到影响紧急加单，让大量订单转向其他芯片电阻大厂。与此同时，因日接单量暴增，加上公司未交订单排超 4 个月以上，全球第三大芯片电阻大厂昨日传出暂停接单，恢复接单日未定。（国际电子商情）

利亚德南方总部主体结构封顶

2021 年 1 月 12 日，利亚德集团南方总部产业园主体结构顺利封顶。利亚德南方总部将以 LED 高清显示技术、LED 创意显示技术、LED 智能照明设计及应用等声光电技术为核心，建设 LED 高端制造、夜游经济等关于 LED 应用领域全生态范围的产业链集群。南方总部建成后，所有在深圳的利亚德下属生产型企业将全部迁入南方总部，届时工业年产值预计可达 50 亿元。（群智咨询）

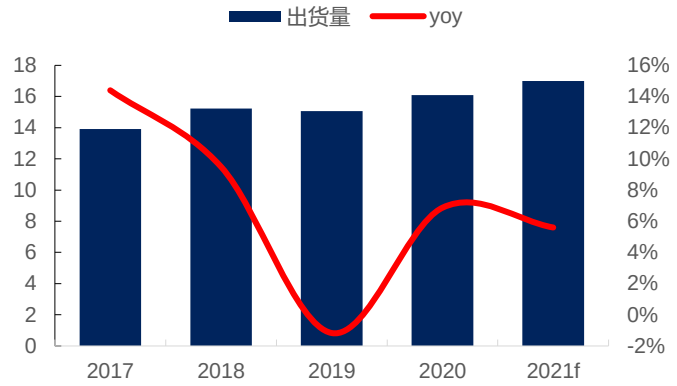
附录三：近期重要行业数据整理更新

图 11：近五年 NB 出货量（百万台）



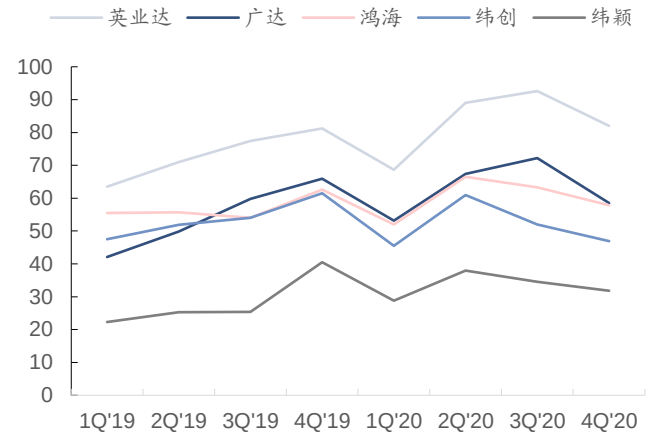
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 12：近五年全球伺服器出货量（百万台）



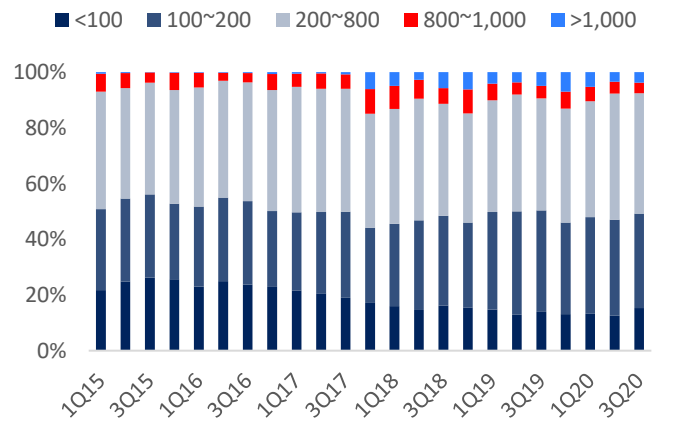
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 13：台企伺服器代工出货量（万台）



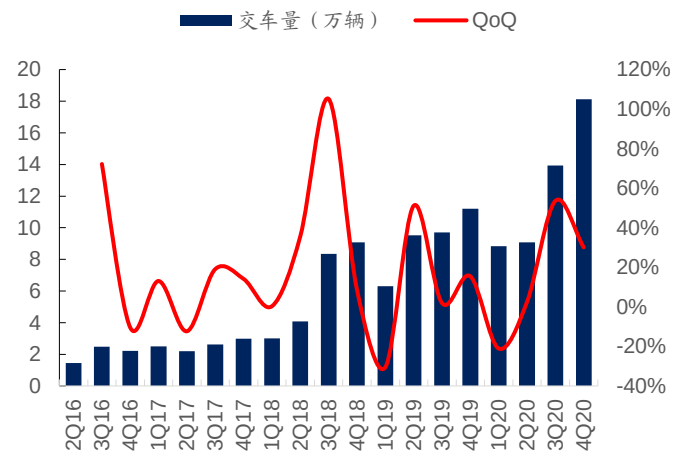
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 14：各价位段智能手机全球出货占比（以美元计）



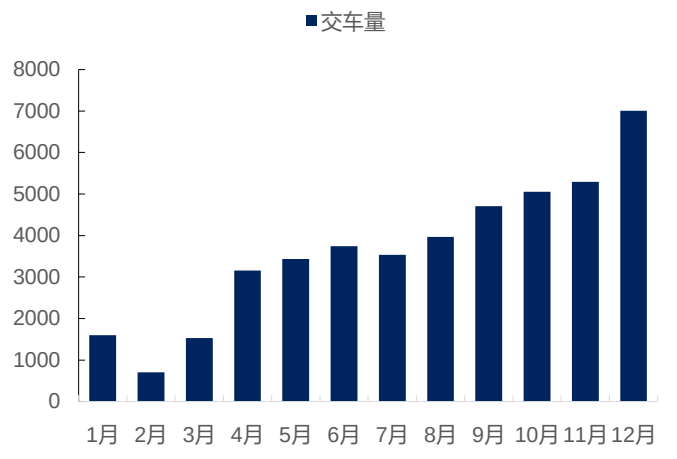
资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 15：特斯拉全球电动车季度交车量情况（万辆）



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

图 16：蔚来 2020 年 1-12 月电动车交车量变化（辆）



资料来源：Digitimes，信达证券研发中心

附录四：上市公司重要公告和未来大事提醒

【TCL 科技】发布 2020 年度业绩预告，预计实现归母净利 42.0-44.6 亿元，同比增长 60%-70%。

【卓胜微】发布 2020 年度业绩预告，预计盈利：100-105 万元，比上年同期增长：101.14-111.20%。

【华峰测控】发布 2020 年年度业绩预增公告，预计 2020 年实现归母净利增加 0.78-1.08 亿元，同比增加 76.49-105.91%。

【精测电子】发布关于公司特定股东及高级管理人员减持计划的预披露公告，武汉精至计划减持不超过公司总股本 1.14%的股份，即 282.18 万股；副总经理杨慎东计划减持不超过公司总股本 0.0452%的股份，即 11.16 万股；财务负责人游丽娟计划减持不超过公司总股本 0.0018%的股份，即 4,500 股。

【聚辰股份】发布 2020 年年度业绩预增公告，公司间接参与中芯国际科创板股票发行的战略配售，按照出资份额确认的公允价值变动收益增加本报告期业绩约 7,620 万元。受此影响，公司预计 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润约 16,105 万元，较 2019 年度将增加约 6,594 万元，同比增加 69.33%左右。扣非净利约 6,020 万元，较 2019 年度将减少约 3,771 万元，同比减少 38.51%左右。

【木林森】发布关于公司高级管理人员增持公司股份计划的公告，公司董事会秘书肖燕松先生拟增持公司股票不低于人民币 2,500 万元。

【奥海科技】发布 2020 年度业绩预告，预计 2020 年归母净利 32,000 万元-35,000 万元，同比增长 44.45%-57.99%。

【沪硅产业】发布 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案，拟向不超过 35 名合格投资者发行公司股票不超过 7.44 亿股，不超过发行前公司总股本的 30%。

【闻泰科技】发布股东解除部分股权质押的公告，公司股东康旅集团解除质押公司股份 2898 万股，占公司总股本 2.33%，占其持有股份数 35.90%。操作后，剩余质押股份数 4861.14 万股，占公司总股本 3.90%，占其持有公司股份数 60.21%。

【顺络电子】发布董事长部分股票质押及解除质押的公告，公司大股东暨董事长袁金钰先生近期质押公司股份 760 万股，解除质押 280 万股，剩余质押数 8810 万股，占公司总股本 10.93%，占其持有公司股份数 76.99%。

【安洁科技】经中国证券监督管理委员会核发的批复核准。公司向 19 名特定投资者非公开发行 6718.36 万股人民币普通股股票。公司本次募集资金已划至公司指定的资金账户，实际募集资金净额为 10.05 亿元，上述募集资金已全部到位。

【兴旺达】公司的转债开始转股，转股价格：21.24 元/股

【韦尔股份】高管减持完成。副总经理纪刚先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 80 万股，占公司总股本的 0.09%；本次减持后，纪刚先生持有公司 544 万股，占公司总股本的 0.63%。董秘贾渊先生累计减持公司股份 55.5 万股，占公司总股本的 0.06%；本次减持后，贾渊先生持有公司 355 万股，占公司总股本的 0.41%。

【三安光电】大股东发生股票质押。三安电子及其控股股东三安集团合计持有本公司股份数量为 14.57 亿股股份，占公司总股本比例为 32.54%。本次部分股票质押后，两家累计质押股票 5.29 亿股，质押股份约占两家所持有本公司股份比例的 36.32%。

【京东方 A】2021 年非公开发行 A 股股票预案，本次非公开发行募集资金净额预计不超过 200 亿元，募集资金将用于“收购武汉京东方光电 24.06%的股权”、“对重庆京东方显示增资并建设京东方重庆第 6 代 AMOLED（柔性）生产线项目”、“对云南创视界光电增资并建设 12 英寸硅基 OLED 项目”、“对成都京东方医院增资并建设成都京东方医院项目”、“偿还福州城投集团贷款”以及补充流动资金。

【京东方 A】关于拟收购子公司武汉京东方光电科技有限公司部分股权的公告，本次非公开发行募集资金，65 亿元将用于收购武汉临空港工发投所持武汉京东方光电 14.44%股权和长柏基金所持武汉京东方光电 9.62%股权。

【兆易创新】关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告，本激励计划授予 289 名管理人员、核心及骨干人员公积 340.86 万股票期权；向 308 名激励对象授予 318.79 万股限制性股票。

【韦尔股份】股东减持后持股比例低于 5%的提示性公告，青岛融通在 2020.8.31 至 2021.1.14 期间，累计减持公司 1880 万股，占公司总股本的 2.17%。本次权益变动后持股比例低于 5%。

【三安光电】关于控股股东部分股份质押的公告，三安电子持有本公司股份数量为 12.13 亿股份，占公司总股本比例为 27.10%。本次股票质押 1000 万股后，累计质押数量为 4.89 亿股，占公司总股本比例 10.91%。

研究团队简介

方　竞，西安电子科技大学本硕连读，近 5 年半导体行业从业经验，有德州仪器等外企工作经历，熟悉半导体及消费电子产业链。同时还是国内知名半导体创业孵化平台 IC 咖啡的发起人，曾协助多家半导体公司早期融资。2017 年在太平洋证券，2018 年在招商证券，2020 年加入信达证券，任电子行业首席分析师。所在团队曾获 19 年新财富电子行业第 3 名；18/19 年《水晶球》电子行业第 2/3 名；18/19 年《金牛奖》电子行业第 3/2 名。

李少青，武汉大学硕士，2018 年加入西南证券，2020 年加入信达证券，覆盖半导体产业链。

刘志来，上海社会科学院金融硕士，2020 年加入信达证券，覆盖消费电子产业链。

童秋涛，复旦大学资产评估硕士，2020 年加入信达证券，从事电子行业研究。

机构销售联系人

区域	姓名	手机	邮箱
销售总监	韩秋月	13911026534	hanqiuyue@cindasc.com
华北	卞双	13520816991	bianshuang@cindasc.com
华北	刘晨旭	13816799047	liuchenxu@cindasc.com
华北	顾时佳	18618460223	gushijia@cindasc. com
华北	魏冲	18340820155	weichong@cindasc.com
华北	阙嘉程	18506960410	quejiacheng@cindasc.com
华北	祁丽媛	13051504933	qiliyuan@cindasc.com
华东总监	王莉本	18121125183	wangliben@cindasc.com
华东	孙斯雅	18516562656	sunsiya@cindasc.com
华东	吴国	15800476582	wuguo@cindasc.com
华东	张琼玉	13023188237	zhangqiongyu@cindasc.com
华东	国鹏程	15618358383	guopengcheng@cindasc.com
华东	李若琳	13122616887	liruolin@cindasc.com
华南总监	王留阳	13530830620	wangliuyang@cindasc.com
华南	陈晨	15986679987	chenchen3@cindasc.com
华南	王雨霏	17727821880	wangyufei@cindasc.com
华南	江开雯	18927445300	jiangkaiwen@cindasc.com
华南	闫娜	13229465369	yanna@cindasc.com
华南	焦扬	13032111629	jiaoyang@cindasc.com

分析师声明

负责本报告全部或部分内容的每一位分析师在此申明，本人具有证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师,以勤勉的职业态度,独立、客观地出具本报告；本报告所表述的所有观点准确反映了分析师本人的研究观点；本人薪酬的任何组成部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体分析意见或观点直接或间接相关。

免责声明

信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)具有中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由信达证券制作并发布。

本报告是针对与信达证券签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。信达证券不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。客户应当认识到有关本报告的电话、短信、邮件提示仅为研究观点的简要沟通，对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告是基于信达证券认为可靠的已公开信息编制，但信达证券不保证所载信息的准确性和完整性。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告最初出具日的观点和判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会出现不同程度的波动，涉及证券或投资标的的历史表现不应作为日后表现的保证。在不同时期，或因使用不同假设和标准，采用不同观点和分析方法，致使信达证券发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告，对此信达证券可不发出特别通知。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测仅供参考，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。

在法律允许的情况下，信达证券或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能会为这些公司正在提供或争取提供投资银行业务服务。

本报告版权仅为信达证券所有。未经信达证券书面同意，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、转发或引用本报告的任何部分。若信达证券以外的机构向其客户发放本报告，则由该机构独自为此发送行为负责，信达证券对此等行为不承担任何责任。本报告同时不构成信达证券向发送本报告的机构之客户提供的投资建议。

如未经信达证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。信达证券将保留随时追究其法律责任的权利。

评级说明

投资建议的比较标准	股票投资评级	行业投资评级
本报告采用的基准指数 ：沪深 300 指数（以下简称基准）； 时间段：报告发布之日起 6 个月内。	**买入：**股价相对强于基准 20%以上；	**看好：**行业指数超越基准；
	增持：股价相对强于基准 5%～20%；	**中性：**行业指数与基准基本持平；
	持有：股价相对基准波动在±5% 之间；	**看淡：**行业指数弱于基准。
	卖出：股价相对弱于基准 5%以下。	

风险提示

证券市场是一个风险无时不在的市场。投资者在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。建议投资者应当充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险并谨慎行事。

本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业顾问的意见。在任何情况下，信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。